(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2025年9月25日(25.09.2025)

WIPO | PCT

(10) 国際公開番号
WO 2025/197277 A1

(51) 国際特許分類:
H01L 21/50 (2006.01) *H01L 23/29* (2006.01)
H01L 21/56 (2006.01) *H01L 23/31* (2006.01)

(21) 国際出願番号： PCT/JP2025/001690

(22) 国際出願日： 2025年1月21日(21.01.2025)

(25) 国際出願の言語： 日本語

(26) 国際公開の言語： 日本語

(30) 優先権データ：
特願 2024-047205 2024年3月22日(22.03.2024) JP

(71) 出願人: 三井化学ＩＣＴマテリア株式会社(**MITSUI CHEMICALS ICT MATERIA, INC.**) [JP/JP]; 〒1040028 東京都中央区八重洲二丁目２番１号 (JP).

(72) 発明者: 三浦 徹(**MIURA Toru**); 〒1040028 東京都中央区八重洲二丁目２番１号 三井化学ＩＣＴマテリア株式会社内 (JP). 尾▲崎▼ 惇史(**OZAKI Atsushi**); 〒1040028 東京都中央区八重洲二丁目２番１号 三井化学ＩＣＴマテリア株式会社内 (JP).

(74) 代理人: 速水 進治，外(**HAYAMI Shinji** et al.); 〒1410031 東京都品川区西五反田７丁目９番２号 ＫＤＸ五反田ビル９階 (JP).

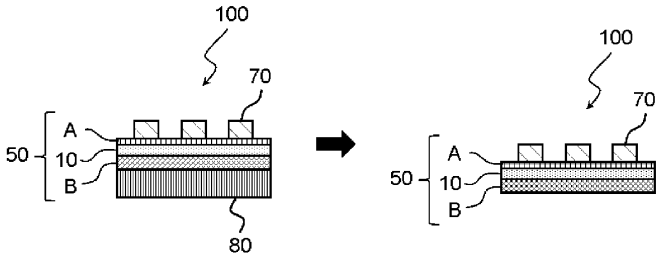
(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UY, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS,

WO 2025/197277 A1

(54) **Title:** METHOD FOR MANUFACTURING ELECTRONIC DEVICE AND METHOD FOR MANUFACTURING STAINLESS STEEL SUBSTRATE

(54) 発明の名称： 電子装置の製造方法およびステンレス鋼基板の製造方法



(57) **Abstract:** This method for manufacturing an electronic device includes: a step for preparing a structure (100) which comprises an adhesive film (50) provided with an adhesive resin layer (A), a substrate layer (10), and an adhesive resin layer (B) in that order, and which comprises an electronic component (70) on the adhesive resin layer (A) side of the adhesive film (50), and a support substrate (80) on the adhesive resin layer (B) side of the adhesive film (50); and a step for reducing the adhesive strength of the adhesive resin layer (B) through a heat treatment to peel off the support substrate (80) from the structure (100). The support substrate (80) includes a stainless-steel substrate having an oxide film on a surface thereof.

(57) 要約：粘着性樹脂層（Ａ）、基材層（１０）および粘着性樹脂層（Ｂ）をこの順番で備える粘着性フィルム（５０）と、粘着性フィルム（５０）の粘着性樹脂層（Ａ）側に電子部品（７０）と、粘着性フィルム（５０）の粘着性樹脂層（Ｂ）側に支持基板（８０）と、を備える構造体（１００）を準備する工程と、加熱処理により粘着性樹脂層（Ｂ）の粘着力を低下させて構造体（１００）から支持基板（８０）を剥離する工程と、を含み、支持基板（８０）が、表面に酸化膜を有するステンレス鋼基板を含む、電子装置の製造方法。

［続葉有］

MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類：

一　国際調査報告（条約第21条(3)）